



部品内蔵技術委員会主催 2023年度第二回公開研究会

主催：EPADs技術調査委員会

◆公開研究会のご案内

部品内蔵技術委員会のEPADs技術調査研究会より2023年度第二回目となる公開研究会を開催します。

今回のテーマは、「部品内蔵技術に向けたVUCA時代の配線技術と材料」となります。

実装材料や配線技術について、幅広くご紹介いただきます。

開催日時 2023年9月20日水曜日 13:10～17:10

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10～13:15 オープニング 司会 EPADs技術調査研究会 主査 藤村 迅

13:15～14:00 「テーマ 伸縮性アクリル系エラストマー、その複合導電材料の開発」
大阪有機化学工業株式会社 赤石 良一 氏



<概要>

現在、ストレッチャブルデバイスは研究が進み、柔軟、軽量、薄膜化され、皮膚上で生体信号がセンシングされている。これらを背景に、アクリル酸エステルより高柔軟・高伸縮性エラストマーを開発した。印刷可能な伸縮性導電材料に応用可能な導電材料について報告する。

14:00～14:45 「テーマ 高周波伝送における導体損失低減について
ー 基材と銅配線の界面を平滑にできるシード材料 ー」
DIC株式会社 白髪 潤 氏



<概要>

平滑な基材の上に導電性の銀ナノ粒子層を設け、その上に電解銅めっきを施すことで銅張積層板を作製し、プリント配線板の高周波伝送における導体損失を低減する技術について紹介する。この作製方法によるプリント配線板は、基材／銅配線間の界面が平滑となり、高周波伝送における導体損失を低減できる。

14:45～14:55 休憩

14:55～15:40 「テーマ 部品内蔵配線板WABE Package®」
株式会社フジクラ 小内 聡 氏



<概要>

フジクラが開発し、現在量産している部品内蔵配線板『WABE Package®』について、構造及びプロセスフローを紹介する。

特に『WABE Package®』として最も特長的である、ICを垂直方向に複数内蔵可能な『チップスタックWABE®』について、信頼性評価結果を中心に報告する。

15:40～16:25 「テーマ 壊れないマイクロビア接続のための無電解銅めっき技術」
奥野製薬工業株式会社 北原 悠平 氏



<概要>

ビア底に位置する内層銅 - 無電解銅めっき皮膜 - 硫酸銅めっき皮膜の銅 - 銅間の結晶方位をそろえる“結晶連続性”を実現でき、無電解銅めっき皮膜に存在する欠陥(ナノボイド)を抑制することが可能なマイクロビア接続のための無電解銅めっき技術を紹介する。

16:25～17:10 「テーマ 4端子測定による基板品質向上への取り組みについて」
日置電機株式会社 塩崎 和彦 氏



<概要>

電子機器の高機能化に伴い、プリント配線板の検査は単なる導通・絶縁だけではなく、その特性値による良否の判断が求められている。本講演では特性値測定に不可欠な4端子測定を用いた検査手法と、その測定結果を有効利用した基板品質向上への取り組みについて紹介する。

参加要項

定 員 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- ⑥参加費決済方法:クレジットカード決済か銀行振込をご選択いただけます。
銀行振込の場合の振り込み先は、マイページ「決済」タブより出力いただく請求書の下部をご確認ください。

* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン利用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)